

2021 年度第 3 回 F3D 公開講座

地域産業デジタル化支援事業



ポスト 5G を支える先端半導体製造機器

2021 年 7 月 21 日 (水) 13:45 ~ 16:30

共催：大阪大学フレキシブル 3D 実装協働研究所 ZOOM webinar
経済産業省近畿経済産業局 on-line 開催

後援：(一財) 大阪大学産業科学研究協会、(一社) 日本電気計測器工業会

14:00~14:45

TOWA (株) 平野 義和 氏

先端半導体における FO-WLP/PLP
モールドイングソリューション



15:00~15:45

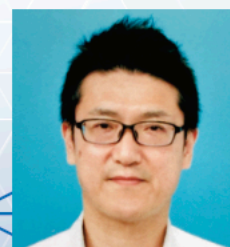
東レエンジニアリング (株) 新井 義之氏

μLED ディスプレイ向け設備のご紹介

15:45~16:30

東朋テクノロジー (株) 遠藤 貴士氏

材料開発から成膜条件管理まで~薄膜応力測定



※公開講座内容について、都合により一部変更になる可能性があります。ご了承ください。

【お申し込み方法】

下記 QR コード・F3D 実装協働研究所 HP お申込みフォーム・メール
いずれかにてお申し込み下さい。

※メールでお申込みの際は、お名前・ご所属・
Zoom 接続可能メールアドレスをご記入ください。



大阪大学フレキシブル 3D 実装協働研究所

URL <http://www.f3d.sanken.osaka-u.ac.jp/>

MAIL f3d@sanken.osaka-u.ac.jp

TEL 06-6879-4295 (平日 9:00-17:00)

先端半導体における FO-WLP/PLP モールディングソリューション

TOWA (株) 平野 義和氏

近年の先端半導体分野においては微細化のみならず、2.5D/3D 等 構造的に高速化・歩留まり向上を目指した後工程開発の重要性が高まっています。本講座では先端半導体の課題に対する弊社独自のコンプレッションモールド（圧縮成型）によるソリューションについてご紹介します。

μLED ディスプレイ向け設備のご紹介

東レエンジニアリング (株) 新井 義之氏

次世代ディスプレイとして注目されているμLED ディスプレイの最大の課題は、□30μm以下のLEDを4Kテレビでは2500万個もの膨大な個数のLEDをパネルに高精度に実装することである。

量産に対応可能な高速性を実現する超高速転写装置、LEDの全数検査を実現するPL検査装置、不良LED除去に対応したレーザートリミング装置をご紹介します。

材料開発から成膜条件管理まで～薄膜応力測定

東朋テクノロジー (株) 遠藤 貴士氏

さらなる高速化、高集積化が求められる先端半導体分野において、基板および膜材料の開発、選定、管理はますます重要となっています。また、成膜装置における成膜条件もよりシビアな管理が求められています。本講座では各現場で幅広く使っている東朋テクノロジーの薄膜応力測定装置をご紹介します。